



主要特点

内部集成 2: 4 译码器

通道数目: 4

通带频率: 32 - 35 GHz

33 - 36 GHz

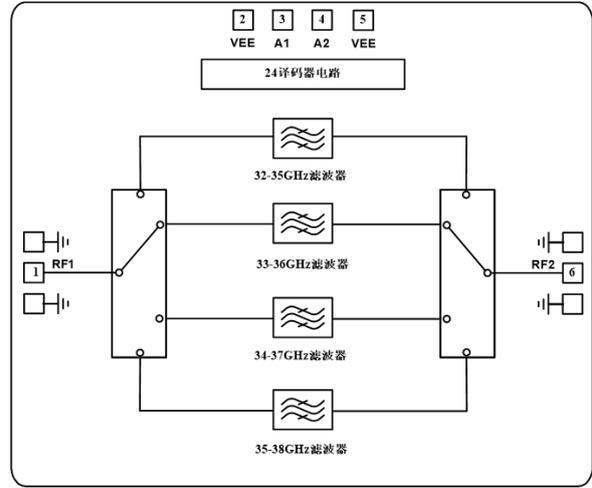
34 - 37 GHz

35 - 38 GHz

功耗: -5 V @ 8 mA

芯片尺寸: 2.5 x 2.5 x 0.1 mm³

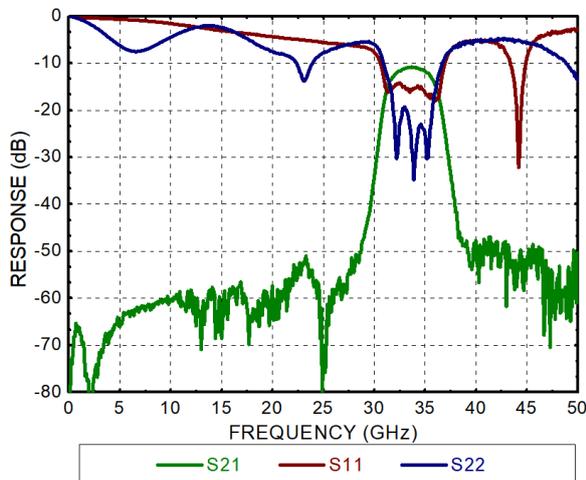
功能框图



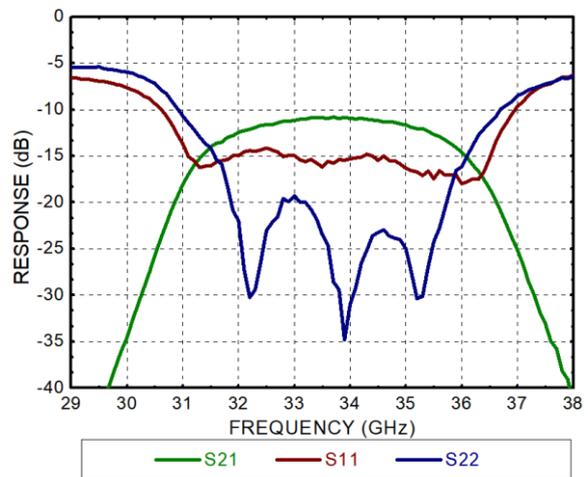
性能指标 ($T_A = +25^\circ\text{C}$, $VEE = -5\text{V}$)

参数	32-35GHz	33-36GHz	34-37GHz	35-38GHz	单位
插入损耗	12	12	12	12	dB
带内平坦度	± 0.8	± 0.8	± 0.8	± 0.9	dB
回波损耗	15	15	15	15	dB
带外抑制	35 @ 29GHz 30 @ 38GHz	40 @ 30GHz 30 @ 39GHz	30 @ 31GHz 30 @ 40GHz	35 @ 32GHz 30 @ 41GHz	dBc

32-35GHz反射系数

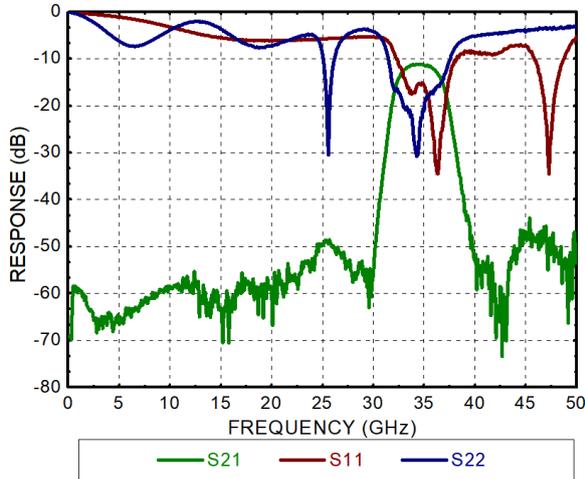


32-35GHz反射系数

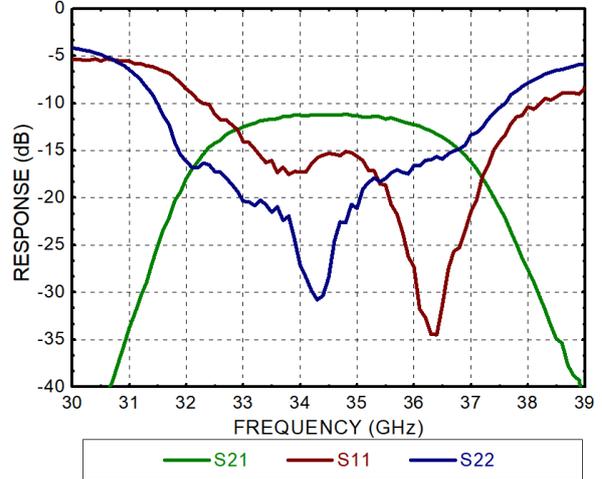




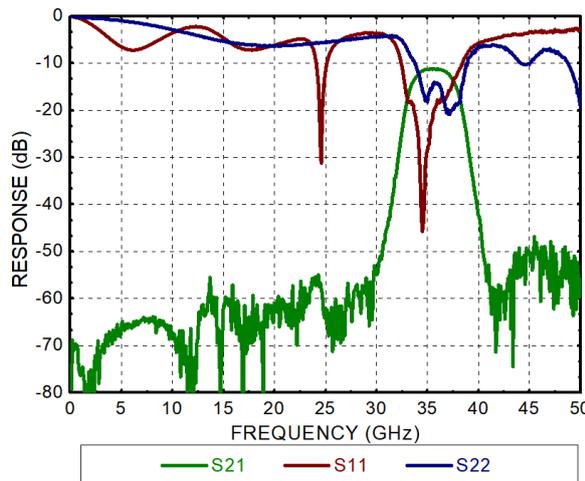
33-36GHz反射系数



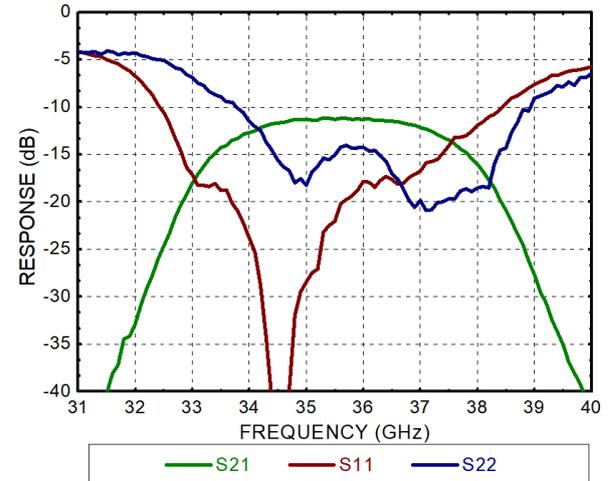
33-36GHz反射系数



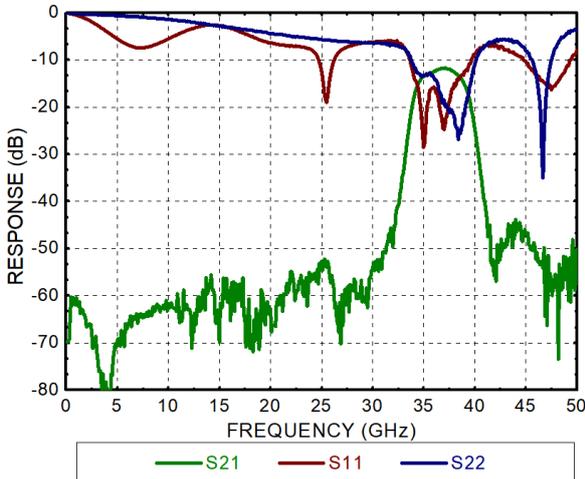
34-37GHz反射系数



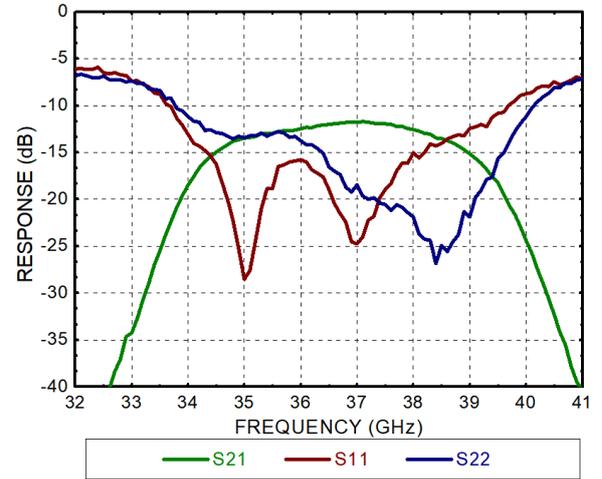
34-37GHz反射系数



35-38GHz反射系数



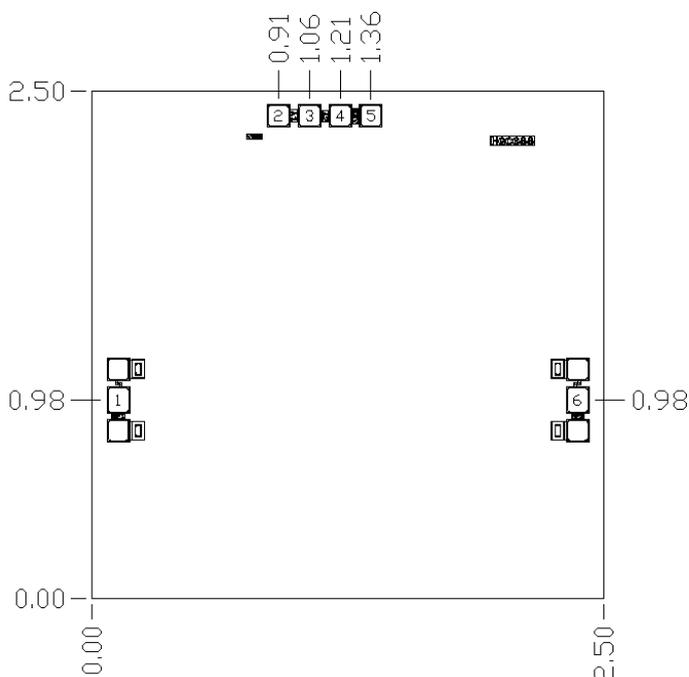
35-38GHz反射系数





物理参数

单位: mm



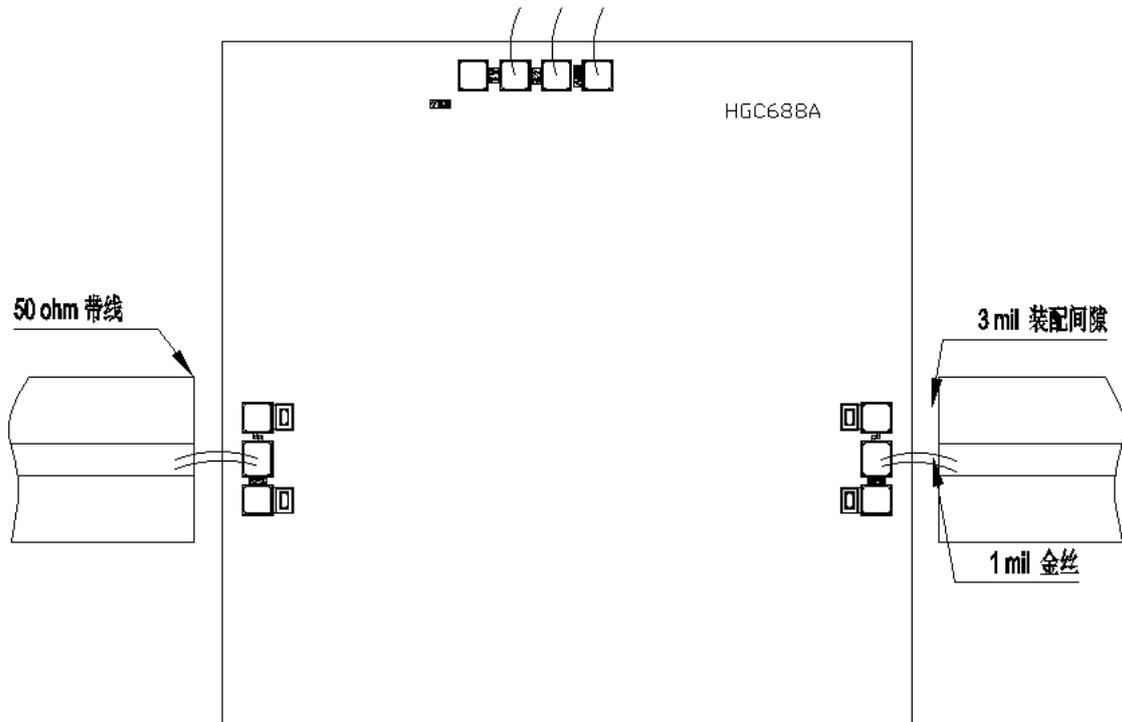
焊盘描述

焊盘序号	功能	描述
1、6	RF1, RF2	该焊盘是 RF 信号输入输出端, DC 耦合并匹配至 50 Ohm, 如果 RF 电位不是 0 V, 那么需要外部加入隔直电容
2、5	VEE	该焊盘是直流电源输入端, 使用时任选一端接-5V 电压
3、4	A1, A2	该系列焊盘为 0/+5V 控制电压输入端口, 控制关系见真值表
芯片背面	GND	芯片背面必须连接至 RF/DC 地

真值表

通带频率	A1	A2
32-35GHz	0	0
33-36GHz	0	1
34-37GHz	1	0
35-38GHz	1	1
“0” 电平范围: 0~0.5V; “1” 电平范围: 2.3~5V		

装配图



注意事项

1. 本芯片属于静电敏感器件，运输、存储和使用过程中注意静电防护
2. 厚度为 100 μm
3. 典型键合焊盘尺寸为 $120 \times 100 \mu\text{m}^2$
4. 键合焊盘金属化：金
5. 芯片背面镀金
6. 芯片背面接地
7. 未标注的键合焊盘不需要连接
8. 钝化层信息：材质：SiN；厚度：0.6 μm ，

极限参数

1. 电源电压：-6 V
2. 射频输入功率：+27 dBm
3. 储存温度：-65 ~ +150 $^{\circ}\text{C}$
4. 工作温度：-55 ~ +85 $^{\circ}\text{C}$